**新产品设计与开发过程总结**

**项目编号**：

**项目名称**：

**拟制： 审核： 批准：**

***文 件 控 制***

**变更记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 作者 | 版本 | 更改说明 |
|  |  | A/0 | 首次发布 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**审阅**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 审阅者 | 意见 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**分发**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 接收人 | 地点 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

目录

[1.项目简介及完成情况 4](#_Toc28337)

[1.1项目简介 4](#_Toc3792)

[1.2预期的验收指标及实际达到的指标 4](#_Toc21009)

[1.3预期的研发进度及实际研发进度 4](#_Toc18209)

[1.4后期的可改进措施 4](#_Toc28261)

[2.设计中的经验与总结 4](#_Toc23662)

[2.1电子部分总结 4](#_Toc16713)

[2.1.1硬件及PCB部分总结 4](#_Toc13962)

[2.1.2程序设计部分总结 4](#_Toc6461)

[2.2结构部分总结 4](#_Toc24558)

[2.3项目管理总结 4](#_Toc23793)

[3.其他 4](#_Toc23126)

# 1.项目简介及完成情况*（一级标题，宋体，三号，加粗）*

*（正文，宋体，小四，首行缩进2个字符，行距20磅）*

## 1.1项目简介*（二级标题，宋体，四号，加粗）*

## 1.2预期的验收指标及实际达到的指标

## 1.3预期的研发进度及实际研发进度

## 1.4后期的可改进措施

# 2.设计中的经验与总结

## 2.1电子部分总结

## 2.1.1硬件及PCB部分总结*（三级标题，宋体，小四，加粗）*

### 2.1.2程序设计部分总结

## 2.2结构部分总结

## 2.3项目管理总结

# 3.其他